

プラズマエッチングにおける

パーティクル・プロセス異常の検出技術とプラズマ耐性部材

◆日時：2024年12月19日(木) 10:30~16:30

◆会場：【WEB限定セミナー】※在宅、会社にながらセミナーを受けられます

◆聴講料：1名につき55,000円(税込、資料付)

※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

・1名でお申込みされた場合、1名につき49,500円(税込)

・2名同時でお申し込みされた場合、2人目は無料(2名で55,000円(税込))

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師：(国研)産業技術総合研究所 センシングシステム研究センター

複合センシングデバイス研究チーム 主任研究員 博士(工学) 笠嶋 悠司 氏

現在、半導体は産業上の一部品としてではなく、経済安全保障にも関わる極めて重要な「特定重要物資」として取り扱われています。半導体製造技術の最先端では2nm、更にはより細な製造技術の研究開発も進められています。その一方、我が国の半導体産業の特長の一つは、車載用マイコンやセンサ用半導体、パワー半導体を始めとして最先端の微細製造技術を必ずしも必要としない半導体デバイスに競争力を有することです。本セミナーでは、後者の製造を多く担う、いわゆるレガシーファブの量産ラインの前工程において、装置稼働率や歩留まりの向上に必要となる製造技術について紹介します。前工程の中でも、特に収益性に関わりが大きいプラズマエッチングプロセス及びその装置に関し、不良発生の抑止や予知保全、メンテナンス費用削減、装置機差の低減等に資する技術について解説します。

1. はじめに

1.1 半導体を取り巻く情勢、半導体産業界の動向

1.2 半導体の製造工程とプラズマプロセス

1.3 量産ラインにおけるプラズマプロセスの課題

1.4 半導体製造効率と歩留まり

1.5 プラズマエッチングプロセス

2. プラズマエッチングプロセスにおけるパーティクルの課題

2.1 パーティクル対策の必要性

2.2 パーティクルのその場検出手法

2.3 パーティクルの発生メカニズム

3. プラズマプロセスにおける異常モニタリング・検出技術

3.1 プロセス異常モニタリング

3.2 異常放電

3.3 各種モニタリング・検出手法

(アコースティックエミッション手法、

プラズマインピーダンスモニタリング手法等)

4. プラズマ耐性材料とその評価技術

4.1 プロセスチャンバー用部品部材の腐食とパーティクル発生

4.2 高プラズマ耐性材料

4.3 チャンバー部品部材のプラズマ耐性評価手法

(セラミックス部材を例として)

『プラズマエッチング【WEBセミナー】【WEBセミナー】』セミナー申込書

| | | | |
|-------|---|-----|--|
| 会社・大学 | | | |
| 住所 | 〒 | | |
| 電話番号 | | FAX | |

| お名前 | 所属・役職 | E-Mail |
|-----|-------|--------|
| ① | | |
| ② | | |

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送

● Webセミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたしまして、別途視聴用のURLをメールにお送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>